

研究成果報告書 (掲載期間 2022.11.1－2023.10.31)

学術書

- (1) 山田靖他：次世代半導体パッケージの最新動向とその材料、プロセスの開発、第4章第7節 pp.284-295、技術情報協会、2023。

審査学術論文

- (1) 山田靖、八坂慎一、大浦賢一、東条三秋：パワー半導体実装用接合材料の基礎物性と信頼性の評価法、エレクトロニクス実装学会誌、26巻、2023、1号、pp.158-166。

学術論文

- (1) 山田靖：パワーデバイス実装用高放熱グラファイト、車載テクノロジー、10巻、2023、5号、pp.28-35。

学会発表

- (1) 松永いづみ、安部登惟、奥村惇史、村瀬葵、田中颯、山田靖：パワー半導体実装用接合材料の高温・高電流密度での信頼性評価、エレクトロニクス実装学会、第33回マイクロエレクトロニクスシンポジウム(MES2023)、2023年9月、名古屋。
- (2) 山田靖、八坂慎一、伊勢谷健司、東条三秋、大竹康久：パワー半導体高温動作用実装構造の信頼性、エレクトロニクス実装学会、第33回マイクロエレクトロニクスシンポジウム(MES2023)、2023年9月、名古屋。
- (3) 高橋昭雄、羽深等、山田靖、唐澤志郎：KAMOME PJ の12年の成果と新しい展開、エレクトロニクス実装学会、第33回マイクロエレクトロニクスシンポジウム(MES2023)、2023年9月、名古屋。